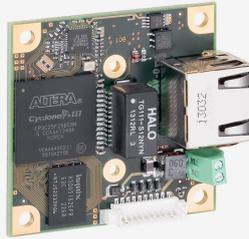
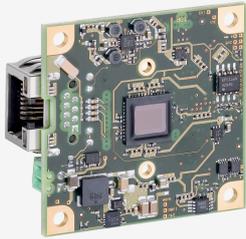


Discontinuado
Este modelo ha sido descatálogo.

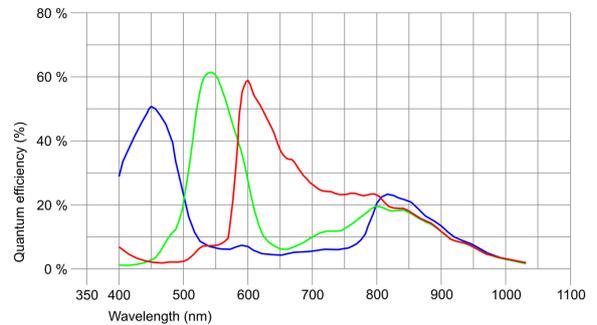


¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak! Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - [haga clic aquí para saber más](#).
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.

Especificación

Sensor

| | |
|--|--|
| Tipo de sensor | CMOS Color |
| Sistema de obturador | Rolling Shutter / Global Start Shutter |
| Caracteristic | Lineal |
| Método de lectura del sensor | Progressive scan |
| Clase de píxeles | 5 MP |
| Resolución | 4,92 Mpx |
| Resolución (h x v) | 2560 x 1920 Pixel |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| CAD | 12 bit |
| Profundidad de color (caméra) | 12 bit |
| Clase de sensor óptico | 1/2,5" |
| Superficie óptica | 5,632 mm x 4,224 mm |
| Diagonal del sensor óptico | 7,04 mm (1/2,27") |
| Tamaño de píxel | 2,2 µm |
| Fabricante | Onsemi |
| Denominación del sensor | MT9P006STC |
| Ganancia (total/RGB) | 12.2x/5.8x |
| AOI horizontal | mayor frecuencia de imagen |
| AOI vertical | mayor frecuencia de imagen |
| AOI ancho de imagen / ancho de paso | 32 / 4 |
| AOI alto de imagen / ancho de paso | 4 / 2 |
| AOI cuadrícula de posición (horizontal/vertical) | 4 / 2 |
| Binning horizontal | mayor frecuencia de imagen |
| Binning vertical | mayor frecuencia de imagen |
| Método binning | Color |
| Factor binning | 2 / 3 / 4 / 6 |
| Subsampling horizontal | mayor frecuencia de imagen |
| Subsampling vertical | mayor frecuencia de imagen |
| Método subsampling | Color |
| Factor subsampling | 2, 3, 4, 5, 6 |



Modelo

| | |
|--|--------------------|
| Rango de frecuencia de píxeles | 4 MHz - 96 MHz |
| Frecuencia de imagen en modo libre | 14 |
| Frecuencia de imágenes disparador (máxima) | 14 |
| Tiempo de exposición (mínimo - máximo) | 0.034 ms - 3404 ms |
| Consumo de potencia | 2,6 W - 3,1 W |
| Memoria gráfica | 60 MB |

Condiciones ambientales

Las temperaturas mencionadas describen la temperatura del aparato exterior de la carcasa de la cámara. Para versiones de placa tenga en cuenta las indicaciones específicas que figuran en la documentación pertinente.

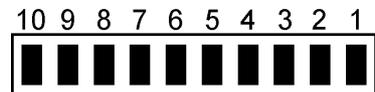
| | |
|---|---------------------------------|
| Temperatura del aparato durante el funcionamiento | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F |
| Temperatura del aparato durante el almacenamiento | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| Humedad (relativa, sin condensación) | 20 % - 80 % |

Conexiones

| | |
|----------------------|---|
| Conexión de interfaz | GigE RJ45 |
| Conexión I/O | Conector Molex de 10 polos (Pico Blade) |
| Alimentación | 12 V - 24 V |

Asignación de pines conexión I/O

| | |
|----|---|
| 1 | Masa (GND) |
| 2 | Vout 3,1 V máx. 100 mA |
| 3 | Entrada de disparador sin optoacoplador |
| 4 | Salida de flash sin optoacoplador |
| 5 | General Purpose I/O (GPIO) 1 |
| 6 | General Purpose I/O (GPIO) 2 |
| 7 | Señal de reloj bus I2C |
| 8 | Señal de datos bus I2C |
| 9 | Vin+ 12 V (160 mA) - 24 V (90 mA) |
| 10 | Vin- (GND) |



Vista de la cámara (vista posterior)

Diseño

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Conexión del objetivo | - |
| Grado de protección IP | - |
| Dimensiones | 45,0 mm x 45,0 mm x 13,0 mm |
| Peso | 24 g |

